

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 吉澤六朗
講演企画委員長 有門経敏

2026 年度 2 月度フォーラム開催案内

平素、半導体産業人協会の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。2026 年 2 月度フォーラムの開催案内をご案内いたします。今年から講演件数を 4 件以上に増やし、半導体のみならず半導体のアプリケーションも含めて幅広く情報を提供致します。今年度第 1 回目は世界の半導体市場動向を取り上げました。それぞれに専門分野を詳しく解説して頂きます。また、講演件数の増加に伴い、従来無料であった会員（個人会員、準会員、賛助会員）の方々からも若干の参加費をいただくことに致しました。会員の皆様にはなにとぞご理解をお願い申し上げます。

記

1. 開催日時

2026 年 2 月 26 日 (木) 13:00~19:00

2. 開催場所

林野会館 (+オンライン)

所在地：〒112-0012 東京都文京区大塚 3-28-7

最寄駅：地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩 7 分

電話：03-3945-6871

3. プログラム (講演時間には Q&A 10 分を含む)

13:00~13:40 (40 分) 『半導体市場の動向の分析と時系列予測法を用いた将来予測』

(一社)半導体産業人協会 法元寛氏

13:40~14:40 (60 分) 『半導体産業の明るい未来』

モルガンスタンレー-MUFG 証券(株) 和田木哲哉氏

14:40~14:50 (10 分) 休憩

14:50~15:50 (60 分) 『中国半導体製造装置メーカーの現在地』

Granage LLP 代表 石田のり子氏

15:50~16:50 (60 分) 『インド半導体及び日印半導体連携について』

(独法)国際協力機構 (JICA) 若林康太氏

16:50~17:20 (30 分) 『ロボット開発の最前線～国際ロボット展 2025 報告』

(一社)半導体産業人協会 有門経敏氏

17:20~19:00 懇親会

4. 講演内容

(1) 『半導体市場の動向の分析と時系列予測法を用いた将来予測』

講師：(一社)半導体産業人協会 法元寛氏

概要：半導体産業人協会では WSTS の半導体デバイス売上高と SEMI の半導体製造装置の売上高のデータを入手し、半導体市場の動向を分析するとともに、時系列予測法を用いて将来の市場動向を予測している。半導体市場は現在、生成 AI 関連の大きな需要に伴い、高性能ロジックやメモリの成長が継続しているが、その他のデバイスの成長は緩やかである。時系列予測法を用いた将来予測は、これまでの推移をもとに統計的に将来の動向を予測する手法であるが、この方法を用いた予測では、2026 年頃からメモリの価格下落に伴う、いわゆるシリコンサイクルを再現する危惧があることが示された。

講師略歴：

大学で物理工学を専攻した後に沖電気工業(株) に入社し、微細加工技術の開発に従事した。その後、東京エレクトロン(株) に転職して市場分析・将来予測などの業務に従事した。定年退職後、半導体産業人協会 SSIS に参加し、編集委員会にて会報アンコールの編集や市場分析チームにて、半導体の市場分析などを担当している。



(2) 『半導体産業の明るい未来』

講師：モルガンスタンレー-MUFG 証券(株) 和田木哲哉氏

概要：半導体業界は、米中貿易問題や相互関税の先行きが見えず、設備投資などが先送りされるなど、先行き不透明感が強まっております。短期的には、厳しい局面を迎えている半導体業界ですが、次の時代を牽引していく様々な技術、製品の離陸が見えてまいりました。中長期的には業界の先行きはさらに明るくなっています。今後の業界の見通しを最新動向を交えてお話し致します。

講師略歴：

1991年3月 早稲田大学卒業、同年4月東京エレクトロン(株) 入社

2000年1月 野村証券(株) 入社、アナリストとして精密機械・半導体製造装置セクター担当

2008年「爆発する太陽電池産業」(東洋経済)、「徹底解析 半導体製造装置産業」(工業調査会) 出版

2022年まで Institutional Investor 誌 アナリストランキング、日経ヴェリタス 人気アナリストランキング、共に精密・半導体製造装置セクターで6年連続1位

2023年1月 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券(株) 入社、24年より現職

2025年 Institutional Investor 誌 アナリストランキング、日経ヴェリタス 人気アナリストランキング、共に精密・半導体製造装置セクターで2年連続1位



(3) 『中国半導体製造装置メーカーの現在地』

講師：Granage LLP 代表 石田のり子氏

概要：中国は国を挙げて半導体産業を推進している。巨額な補助金支援により世界の半導体製造装置購入の3～4割を占めるまでになっている。一方で国産製造装置メーカーも実力を上げている。NAURA（北方華創）や Piotech（拓荊科技）などが急成長しており、270nm 世代では実用レベルに到達している。かつては政府補助金目当ての購入で稼働しない装置も多かったが、現在ではレガシー半導体において問題なく製造できる水準となっている。ただし、最先端半導体製造用の露光装置など技術難度の高い前工程装置の国産化には、まだ10年程度かかる見込みだ。しかし、製造装置、部材から製造技術まで、中国の技術的追い上げは予想を超える速度で進行している。レガシー半導体なら国内で全工程を賄える体制が整いつつある現状を確認する。

講師略歴：ソフトウェア企業、半導体マーケティング企業でマーケティングを担当後、2006年に韓国 FPD 調査会社の Displaybank 日本支社を立ち上げ、アナリストとして調査を担当。2007年に Granage LLP (グラナーージュ) を設立。2008年には日経 BP 社の「FPD International」のイベントプロデューサーを務めた。そのほか、これまでに米国ディスプレイ調査企業日本支社 GM、中国スタートアップ進出支援企業日本支社取締役、HUAWEI 横浜研究所顧問の立場で支援。現在は東京科学大学総合研究院研究員、半導体 IP 管理会社エプリムのチーフアナリスト、三菱 UFJ 銀行半導体バリューチェーン推進室アドバイザーを兼務。経営管理修士 (MBA) 課程修了。



(4) 『インド半導体及び日印半導体連携について』

講師：(独法)国際協力機構 (JICA) 若林康太氏

概要：コロナ禍期間を除きインド経済は好調であり、2000年以降は年平均7%を上回る好況が続いている。モディ首相政権下では、2014年に製造業を強化する「Make in India」を発表し、2030年までに製造業がGDPに占める比率を大幅に引き上げることを目指している。また、インドではスマートフォンや自動車部品、コンピューティング、データセンターなどの幅広い産業の需要増加を受け、半導体及び電子部品の需要増加が見込まれており、半導体のインドの半導体市場は2022年の約330億ドルから、2030年には約1,000億ドルへと飛躍的な成長を遂げる見込みである。他方、現状では国内に商業用の半導体製造拠点を有しておらず、インドは現在、半導体需要の約92%を輸入に依存しており、輸入全体に対して中国からの輸入が最も多く36%を占めている状況である。こうした状況を受け、インド政府は2020年に「自立したインド政策」を掲げ、各産業における輸入依存の低減、自国の生産・輸出拠点としての地位強化を志向する中で、特に半導体をはじめとする電子産業の強化を最重要産業政策と位置付けている。本講演では、インドにおける半導体産業の動向と、日印連携 (特に人材育成分野) の可能性について紹介する。

講師略歴：

2013年 (独法)国際協力機構 (JICA) 入構

2015年 国土交通省にて東日本大震災復興業務に従事

2017年 JICA ブータン事務所の次席所員としてブータン向けオペレーションを実施

2020年 JICA 南アジア部にて、インド鉄道・保健医療・民間連携事業を中心に、円借款オペレーション総括を担当



(5) 『ロボット開発の最前線～国際ロボット展 2025 報告』

(一社)半導体産業人協会 有門経敏氏

概要：人型ロボットに的を絞って国際ロボット展 2025 を見学した。中国ロボットメーカーからの出展が多く、日本企業では中国製ロボットを購入して特定作業をさせるためのソフト開発や AI を使ったティーチング技術を開発する企業が目立った。ロボットに仕事させる方法には、人が操縦、プログラム、AI を使ったティーチングがあるが、いずれも容易ではなく仕事教え込むことが律速している。また、多量のモータを搭載しているため、電力の消費が大きく、動作時間が短いことも問題点である。また、人型ロボットに対する日本と中国のアプローチの違いについても述べる。

講師略歴：

1978年3月 大阪大学大学院工学研究科・応用化学専攻・博士課程修了、工学博士

1978年4月 (株)東芝入社、総合研究所、集積回路研究所配属、ドライエッチング技術開発を担当

2001年4月 長岡技術科学大学客員教授

2001年6月 (株)半導体先端テクノロジーズ出向、取締役第1研究部長

2004年4月 東北大学客員教授

2004年10月 東京エレクトロン(株)入社

2006年4月 同社フェロー就任

2015年12月 同社退職



5. 参加費

今年からできるだけ多くの方に興味を持っていただけるように講演件数を4件以上に増やし、それに伴って、SSIS 会員 (個人会員・準会員・賛助会員) の聴講料を2,000 円/人、DAFS 会員企業の社員の聴講料を4,000 円/人、一般の方の聴講料を8,000 円/人とさせていただきます。なにとぞご理解のほどをお願い申し上げます。なお、懇親会は3,000 円/人に据え置きと致します。

- 会員・準会員・賛助会員：講演聴講：2,000 円/人、懇親会：3,000 円/人
- DAFS 会員企業の社員：講演聴講：4,000 円/人、懇親会：3,000 円/人
- 一般：講演聴講：8,000 円/人、懇親会：3,000 円/人

6. 申し込み方法

- ・ 申し込み締め切り：2026年2月18日（水）17：00
- ・ 申し込み先：info@ssis.or.jp
- ・ 本メールに返信の形で事務局（info@ssis.or.jp）まで申し込みください。

【氏名】 _____ 【ご所属】 _____

【SSIS 会員、DAFS 会員、一般】

SSIS 会員、 DAFS 会員【会社名： _____ 】, 一般

【フォーラム】

林野会館で参加 リモートで参加

【懇親会】

参加 不参加

- ・ 申し込み頂きましたら、受け付けた旨、および SSIS の銀行口座をご案内致しますので、申込んだ方（SSIS 会員、DAFS 会員、一般の方とも）はフォーラム参加費と懇親会参加費（懇親会参加希望者）をお振り込みください。
- ・ オンラインで参加を希望される方には、開催 1 週間前をめどに、フォーラム参加費の振り込みを確認の上、オンライン接続情報（Zoom）をお送りします。
- ・ お申し込みをキャンセルされる場合は、申込期限までをお願い致します。期限を過ぎた場合には、返金致しかねますのでご理解、ご了承をお願い致します。
- ・ ご質問がある場合は、事務局（info@ssis.or.jp）までお問い合わせください。

一般社団法人 半導体産業人協会

<https://www.ssis.or.jp>

TEL：03-6457-3245

FAX：03-6457-3246
